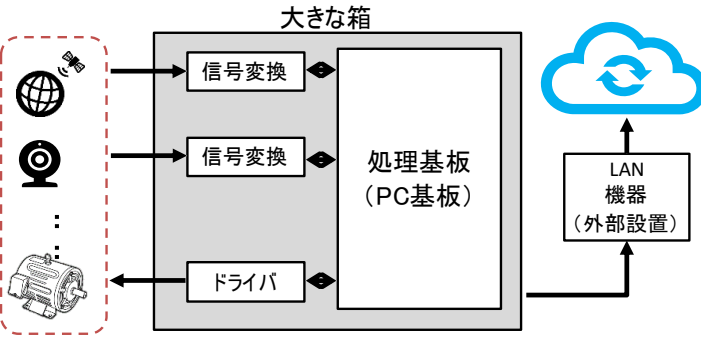
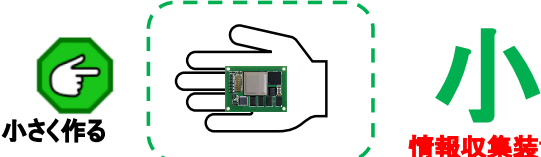
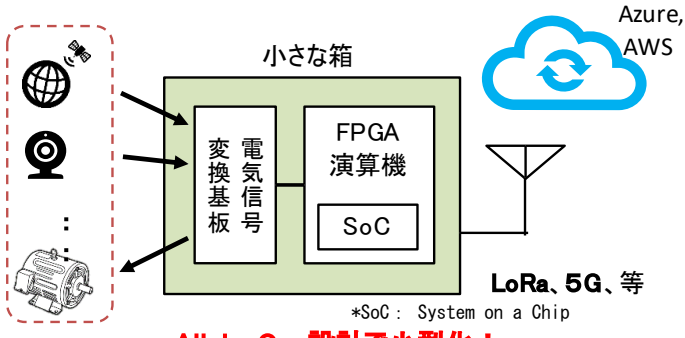


区分/ 工法 展示No	区分: ☐ 電動化 ☒ 軽量・小型化 ☒ 環境寄与 ☒ 自動運転・安全 ☒ 原価低減・品質向上 ☐ その他の技術分野		
	工法: ☐ 部品加工() ☐ 表面処理 ☐ 素材/材料 ☒ 設備/装置 ☐ 金型/治工具 ☒ システム/ソフトウェア ☐ デザイン ☐ 自動化技術 ☐ その他()		
提案名	特定用途向けIoTセンサ小型処理モジュール開発技術		工法 IoT
新規性	業界初		
会社名	(株)デジタル・スパイス		
所在地	〒392-0213 長野県茅野市豊平529-2		
連絡先	URL : https://www.digital-spice.co.jp		
部署名: 開発第2部	Tel No. : 0266-78-3545		
担当名: 藤村 優	E-mail : s-fujimura@digital-spice.co.jp		
主要取引先	☐ 宇宙航空研究開発機構(JAXA) ☐ (株)IHI		
海外対応	☐ 可 (生産拠点を記入) ☒ 否		

<< 提案内容 >>

提案の狙い ☐ 電動化 ☒ 質量低減(軽量化・小型化) ☒ 環境寄与/対策 ☒ 自動運転・安全 ☒ 原価低減 ☐ 品質/性能向上 ☐ 生産(作業)性向上 ☐ その他()	適用可能な製品/分野 - IoT機器(エッジコンピューティング) - スマートファクトリ(工場ライン検査機自動化) - モビリティ社会に貢献するためのIoTソリューション
従来 市販機器を使用した設計 1. 市販機器を使用するため非常にサイズが大きい  2. 機器類の組み合わせによる複雑化  特定用途向けセンサ (独自センサ)	新技術・新工法 SoCボードを使用した設計 1. SoCボードを使用するため非常にサイズが小さい  2. All-in-Oneによるスマート化  All-in-One設計で小型化! Connected/MaaSへの応用 - 小型・低消費電力化を実現した自社のIoT技術を駆使 - ネットワーク接続可、屋外設置も可

セールスポイント(製造可能な精度/材質等) - IOTシステムを具体的な手法をもって実現可能 (自社クラウドシステム【SEWIID】の提供可能) - 独自センサシステムの構築が具体的に可能 - 耐宇宙用途でも開発実績有り (放射線等の耐環境性を考慮した開発も可能) - マルチ処理OS(CAFNOS)搭載によるエッジコンピューティング	問題点(課題)と対応方法 5G通信での対応 → 開発中										
開発進度 (2020年 4月 現在) ☐ アイデア段階 ☐ 試作/実験段階 ☒ 開発完了段階 ☐ 製品化完了段階	特許の有無 無										
従来との比較 <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>コスト</th> <th>質量</th> <th>生産/作業性</th> <th>その他(電力消費量)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>数値割合</td> <td>10~40%低減</td> <td>30~50%低減</td> <td>—</td> <td>1W未満</td> </tr> </tbody> </table>	項目	コスト	質量	生産/作業性	その他(電力消費量)	数値割合	10~40%低減	30~50%低減	—	1W未満	
項目	コスト	質量	生産/作業性	その他(電力消費量)							
数値割合	10~40%低減	30~50%低減	—	1W未満							